

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的增長戰略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)。為配合我們的戰略，我們擬將[編纂]作以下用途及按下列金額分配：

- 約[編纂]% (即約[編纂]港元) 預期將用於建設新設施及升級我們現有的生產設施及產線，包括：
  - 約[編纂]% (即約[編纂]港元) 預期將用於為Multek建設新生產設施，該生產設施專注於高端PCB。此項投資將解決供應缺口問題，並透過提高HDI及軟硬結合板等高端PCB的比例，進一步提升我們的產品組合，這與我們致力於高端製造能力的承諾一致。我們相信，這將使我們能夠滿足市場對高密度、高速PCB的中長期需求及客戶需求，優化我們的產品組合，滿足日益增長的AI運算需求。
  - 約[編纂]% (即約[編纂]港元) 預期將用於升級及增強公司於中國及海外的其他生產設施。具體而言，我們計劃優化製造執行系統與品質管理系統，進行額外軟件升級，以支持我們的智能製造系統。該等改進措施將有助於在整個生產流程中實現更高佳的數據整合，提升營運效率、改進良率管理。最終，該等舉措將強化供應鏈韌性，提升我們的服務能力。

該等投資將使我們能夠緊貼客戶需求，透過將資源集中於高增長產品，把握AI驅動的需求以擴大我們的產品組合，並鞏固在全球一線客戶供應鏈中的地位。

- 約[編纂]% (即約[編纂]港元) 預期將用於潛在戰略投資或收購，以鞏固我們核心業務的技術領先地位及市場領先地位。我們可能在PCB、精密製造及光模塊行業的價值鏈中，選擇性地進行股權投資或收購，重點關注擁有強大技術護城河、清晰產品市場定位及具備可證實客戶需求以支持交叉銷售的目標。

截至最後實際可行日期，我們尚未物色任何特定目標，亦未訂立任何最終協議。

- 約[編纂]% (即約[編纂]港元) 預期將用於償還部分現有債務，包括：
  - (i) 未償還貸款結餘人民幣330.0百萬元，該貸款用於為鹽城東創位於鹽城的精密組件生產設施第一期建設提供資金，到期日為2027年12月20日，年利率為一年期貸款市場報價利率(LPR)減45個基點；

## 未來計劃及[編纂]用途

- (ii)未償還貸款結餘人民幣317.0百萬元，該貸款用於為鹽城東創位於鹽城的精密製造生產設施第二期建設提供資金，到期日為2028年12月21日，年利率為一年期貸款市場報價利率(LPR)減45個基點；
  - (iii)未償還貸款結餘人民幣440.0百萬元，該貸款用於為蘇州東越位於蘇州的精密製造生產設施第一期建設提供資金，到期日為2030年4月6日，年利率為五年期以上貸款市場報價利率(LPR)減100個基點；及
  - (iv)未償還貸款結餘人民幣293.0百萬元，該貸款用於為蘇州東越位於蘇州的精密製造生產設施第二期建設提供資金，到期日為2034年6月4日，年利率為五年期以上貸款市場報價利率(LPR)減110個基點；
- 約[編纂]% (即約[編纂]港元) 預期將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)。我們擬按比例將額外或減少的[編纂]淨額用於上述用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額將為(i)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最高[編纂])、(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]範圍的中位數)及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最低[編纂])。倘[編纂]的[編纂]淨額(包括行使[編纂]的[編纂]淨額)多於或少於預期，我們可能會按比例調整我們就上述用途對[編纂]淨額的[編纂]。

倘我們發展計劃的若干部分因政府政策變動或不可抗力事件等因素而受阻，我們的董事將審慎評估情況，並可能[編纂]的[編纂]淨額。倘[編纂]的擬定用途有任何重大變動，我們將根據香港上市規則作出適當披露。

倘[編纂]的[編纂]淨額未能即時用於上述用途，或我們未能按計劃實行未來發展計劃的任何部分，我們僅會將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。在該等情況下，我們將遵守香港上市規則下的適當披露規定。